

# スプレー装置対応樹脂上のパラジウム残渣除去液

Pd Residue Removing Agent Applicable to Spraying Machine

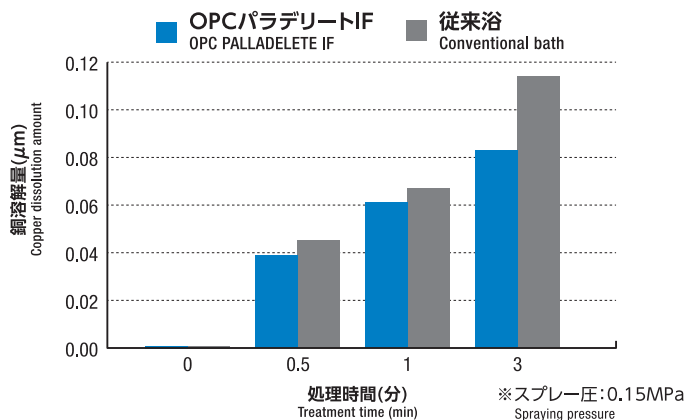
## OPCパラデリートIF

OPC PALLADELETE IF

- レジストへのアタックが少ない硫酸-過酸化水素水タイプのパラジウム除去液  
Palladium remover without damaging resists, sulfuric-acid and hydrogen-peroxide base
- シアン・ヨウ素化合物を用いていない  
Cyanide-, iodine-free
- スプレー装置に対応  
Can use by spraying
- 薬液の分析管理可能  
Can control bath by analysis

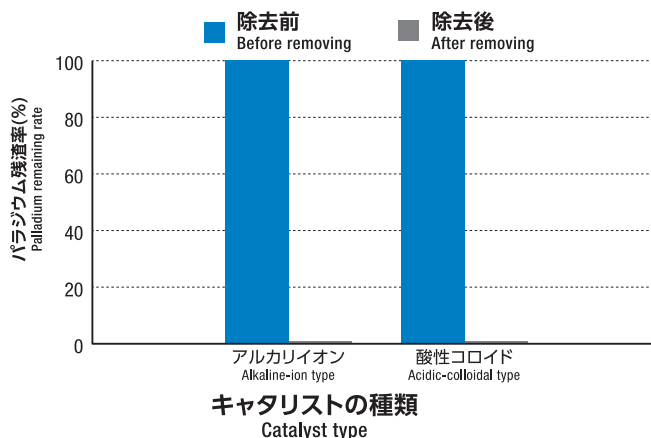
### 銅溶解量の抑制

Reduce copper dissolution



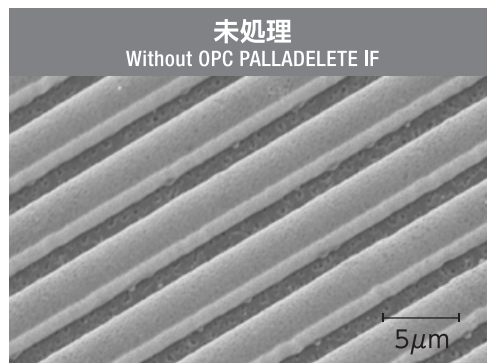
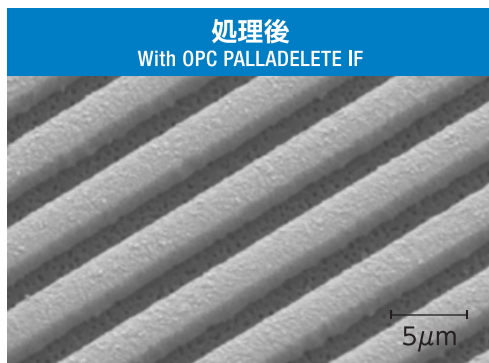
### 高いパラジウム除去性

Strongly remove palladium



### L/S=5/5μmに適応

Realize L/S=5/5μm



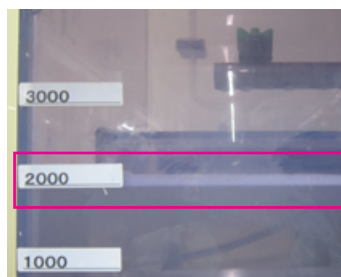
※スプレー圧: 0.15MPa  
Spraying pressure  
処理時間: 3分  
Treatment time 3min

### 発泡性を抑制、スプレー装置に最適

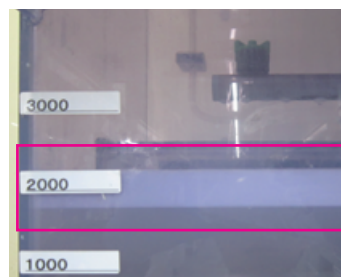
Prevent foaming Best for spraying machine



※スプレー圧: 0.2MPa  
Spraying pressure  
処理時間: 30分  
Treatment time 30min



OPCパラデリートIF  
OPC PALLADELETE IF



従来浴  
Conventional bath